

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安集微电子科技（上海）股份有限公司
2021半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，负责安集科技上市后的持续督导工作，并出具2021年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安集科技签订了保荐协议（明确双方在持续督导期间的权利义务）
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年半年度持续督导期间，公司未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2021年半年度持续督导期间，安集科技及相关当事人不存在违法违规和违背承诺的情况

6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2021年半年度持续督导期间，安集科技及其董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	安集科技执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度，上述制度的履行情况均符合相关法规要求，并督促公司严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	安集科技内控制度符合相关法规要求，可以保证公司的规范运行，督促公司严格执行内部控制制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	公司已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。2021年上半年度持续督导期间，安集科技向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	2021年半年度持续督导期间，保荐机构对安集科技的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合。截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况
11	上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	在2021年半年度持续督导期间，安集科技或其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2021年半年度持续督导期间，安集科技及控股股东不存在未履行承诺的情况

13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2021年半年度持续督导期间,未发现安集科技该等事项
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021年半年度持续督导期间,安集科技未发生该等情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2021年半年度持续督导期间,安集科技未发生该等情况
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2021年半年度持续督导期间,保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司2021年半年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为,安集科技严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）产品更新换代较快带来的产品开发风险

集成电路制造技术和先进封装技术在世界范围内仍然不断被更新并向更先进的技术推进。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司产品与下游客户的技术发展路径适配性下降，或者公司产品的开发速度无法满足客户快速变化的需求，或者相关技术发生重大变革，使得客户减少或限制对公司产品的需求，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（三）客户集中度较高风险

公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额占比较高，公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出

现下降。

（四）原材料供应及价格上涨风险

硅溶胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的重要原材料，主要直接或间接从日本等国家进口，采购相对集中。国际政治、经济环境的变化和不确定性可能会影响国家贸易，对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

此外，公司部分原材料从上游基础化工或精细化工行业采购，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（五）公允价值变动风险

报告期末，公司交易性金融资产余额为 32,885.71 万元，对当期利润的影响金额为 2,524.59 万元。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动,将会对公司的经营业绩产生影响。

（六）汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（七）新冠肺炎风险

新冠肺炎的流行性爆发使半导体行业的正面预期增加了较大的不确定因素，虽然在我国已经得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有较大不确定性，若其继续发展扩大可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

五、重大违规事项

2021年半年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	283,013,381.51	191,742,009.12	47.60
归属于上市公司股东的净利 润	72,180,774.70	49,802,464.40	44.93
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	34,436,067.49	48,997,934.19	-29.72
经营活动产生的现金流量净 额	-51,303,068.53	23,287,039.64	-320.31
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资 产	1,135,256,417.64	1,048,104,787.37	8.32
总资产	1,396,679,817.93	1,287,346,347.95	8.49

2021 年半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.36	0.94	44.68
稀释每股收益（元 / 股）	1.36	0.94	44.68
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.65	0.92	-29.35
加权平均净资产收益率（%）	6.61	5.51	增加 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.15	5.42	减少 2.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例（ %）	21.77	18.08	增加 3.69 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 28,301.34 万元，比去年同期增长 47.60%，主要系客户用量上升所致。

归属于上市公司股东的净利润为 7,218.08 万元，较去年同期增长 44.93%，除受营业收入增长影响之外，还受计入当期损益的政府补助及公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）等公允价值变动影响所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,443.61 万元，较去年同期下降 29.72%，主要系公司因实施股权激励计划产生股份支付费用影响所致。

经营活动产生的现金流量净额为-5,130.31 万元，较去年同期下降 320.31%，主要系经营性应收项目增加及原材料备货增长等所致。

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年分别增长 8.32%和 8.49%，主要系公司经营积累所致。

基本每股收益和稀释每股收益较上期增长 44.68%，主要系公司净利润增长所致。

综上，公司报告期主要财务数据及指标变动具有合理性。

七、核心竞争力的变化情况

2021 年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

（一）深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴，率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，并持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。

公司通过多年持续投入，已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 214 项，另有 226 项专利申请已获受理，均为发明专利。同时，公司持续加强知识产权管理，依照国家《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）制订了完善的知识产权管理体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

（二）持续的研发投入和高效的产品转化

公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游集成电路芯片制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为高端半导体材料行业领域的国内领先、国际先进的供应商。

公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，从解决方案设计、产品研发、测试认证、供应保障、物流配套、技术支持等方面着手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。得益于有竞争

力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

在逻辑芯片、存储芯片、功率器件等半导体技术不断推进过程中，对化学机械抛光液等材料的需求出现了“专”的趋势和特征，客户和供应商联合开发成为成功的先决条件。公司的研发团队在产品的市场需求形成前即与客户沟通，建立紧密联系，以改进现有产品或设计满足客户新产线需要的定制化产品。以 2018 年发布的突破性技术 Xtacking®为例，化学机械抛光工艺对于该技术的实现起到了决定性作用，公司正是通过与客户长时间的紧密合作，定制化研发出了满足客户需求的产品，使得客户的该项技术工艺得以实现。另外，公司经过与客户的长期紧密合作，成功打破 28nm 刻蚀后清洗液 100%进口局面，使 28nm 工艺制程达到了性能和成本的平衡，实现进口替代并稳定量产，28nm 技术的国产化突破，对加速我国芯片制造业的独立自主具有重大意义。

（三）国际化、多元化的人才储备

公司董事长兼总经理 Shumin Wang 和副总经理 Yuchun Wang 均拥有二十余年化学、材料化学、材料工程等专业领域的研究经验，并在全球领先的相关领域公司从事多年的研发、运营和管理的工作。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了丰富的丰富经验。公司副总经理、财务总监 Zhang Ming 在战略计划、人才与团队的建设、销售与市场、公司营运、跨国管理等方面有着丰富的经验，并且成功地实施了多起国内与国际并购，拥有宝贵的国际化经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为持续提升竞争优势提供了保证。

（四）贴近市场和客户的服务模式

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，更布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI，2020 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 8.2%，达到 123.8 亿美元，继续位居全球第一；中国大陆半导体材料市场规模同比增长 12%，超过韩国达到 97.6 亿美元，跃居全球第二。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本

低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

（五）成熟高效的全流程质量保证体系

公司秉承“客户至上、质量导向、持续创新、全面可靠”的质量方针，致力于满足并超越客户的期望。公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001，ISO14001，ISO45001 等管理体系的第三方认证。

八、研发支出变化及研发进展

2021 年半年度，公司研发费用为 61,616,991.68 元，占营业收入的比重为 21.77%，研发费用较去年同期增长 77.71%，主要系股份支付、人力成本及物料消耗增加所致。

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化已量产的14nm技术节点及以上产品的性能及稳定性，为进一步扩大销售提供技术支持；14nm以下技术节点（包括10-7nm）在跟客户紧密合作进行测试并优化。根据存储芯片制造技术的发展，开发用于128层以上3D NAND和19/17nm以下技术节点DRAM用铜及铜阻挡层抛光液。报告期内，成熟产品在多家新建芯片制造厂作为首选供应商与客户一起合作准备量产，多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进。

在钨抛光液方面，公司持续加大产品平台的研发力度，钨抛光液产品平台逐步完善。目前已有多款产品应用到了3D NAND先进制程中，并在持续优化、上量中，稳固了在存储器芯片厂的市场地位。报告期内钨抛光液新产品在DRAM领域及模拟芯片领域完成论证，并在多家客户实现量产销售；钨抛光液新产品在其他应用、领域的客户论证进展顺利；同时后续产品也在持续研发中。

在介电材料抛光液方面，公司与客户紧密合作，共同开发的以二氧化铈为基础的产品突破技术瓶颈，目前已在3D NAND先进制程中实现量产并在逐步上量。报告期内，以二氧化铈为基础的抛光液产品在模拟芯片领域取得重要进展，并已实现量产销售，在逻辑芯片领域处于客户论证阶段。截至目前，公司已成功实现同类产品的国产自主供应。同时，应用于第三代宽带半导体的抛光液配合客户项目试生产需求，进展顺利。

在功能性湿电子化学品方面，公司铝制程及铜大马士革工艺刻蚀后清洗液已量产并且持续扩大应用，广泛应用于8英寸、12英寸逻辑电路、存储器件及特色工艺等晶圆制造领域；光刻胶剥离液广泛应用于后道晶圆级封装等超越摩尔领域。28nm技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液技术取得突破性进展，并已在重要客户上线稳定使用，实现该类产品在28nm技术节点的进口替代，品质性能达到国际领先水平；14nm-7nm技术节点后段硬掩模铜大马士革工艺刻蚀后清洗液的研究及验证正在按计划进行。抛光后清洗液方面，目前已经量产，应用于12英寸芯片制造领域；针对新的应用持续开发新产品、优化产品性能，并在客户端测试论证中。

报告期内公司加速建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。在化学机械抛光液板块，公司与国内具备优质研发及生产资质的合作伙伴已经完成建立全方位长期战略合作关系并展开实质性合作，建立关键原材料硅溶胶的自主可控生产供应能力；在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展。

报告期内，公司及其子公司共获得授权发明专利9项。截至2021年6月30

日，公司及其子公司共获得214项发明专利，其中中国大陆159项、中国台湾46项、美国4项、新加坡3项、韩国2项；另有226项发明专利申请已获受理。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金使用情况及是否合规

截至 2021 年 6 月 30 日，公司的募集资金余额为人民币 33,420.23 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到募集资金	48,392.78
减：募投项目累计使用金额	10,695.15
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,127.59
使用募集账户支付的募投项目款	9,567.56
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	333.55
减：支付的其他发行费用	570.03
减：已部分超募资金永久补充流动资金金额	4,842.85
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	1,469.05
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	33,420.23

注：上述表格出现合计数与各分项数值计算尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理使用制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减持情况

截至 2021 年 6 月末，公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd.直接持有

公司股票 2,256.0328 万股，持股比例为 42.39%。报告期内，公司控股股东持有的股份不存在质押、冻结及减持的情况。公司无实际控制人。

截至 2021 年 6 月末，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	持有公司的权益比例（%）	2021 年 1-6 月质押、冻结及减持情况
1	Shumin Wang	董事长、总经理、核心技术人员	10.98	无
2	Chris Chang Yu	董事	2.78	无
3	朱沛文	董事	-	-
4	陈大同	董事	0.03	无
5	杨磊	董事	-	-
6	郝一阳	董事	-	-
7	张天西	独立董事	-	-
8	李华	独立董事	-	-
9	任亦樵	独立董事	-	-
10	高琦	监事	-	-
11	陈智斌	监事	-	-
12	冯倩	监事会主席、职工代表监事	-	-
13	Zhang Ming	副总经理、财务总监	-	-
14	Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	0.23	无
15	杨逊	副总经理、董事会秘书	0.52	无

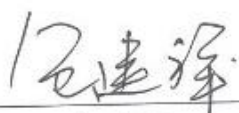
十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


包建祥


康杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

